

预镀 Ni-P 层的 A3 钢表面电化学辅助沉积 TiO_2 薄膜

刘奕茹,高志明*,张正,史达飞

天津大学 材料科学与工程学院,天津 300072

摘要:采用电化学辅助沉积法于自制的 TiPO_4 溶液中,在以 Ni-P 镀层为过渡层的 A3 钢片上制备 TiO_2 薄膜。利用环境扫描电子显微镜(SEM)观察了 TiO_2 薄膜的表面形貌,并用射线能谱仪(EDS)分析了其表面成分;用电化学阻抗谱法和动电位极化曲线测试方法分别研究了 Ni-P/ TiO_2 复合膜和 Ni-P 镀层在 3.5% NaCl 溶液中的耐蚀性,结果表明,两者的电化学腐蚀机理明显不同,且前者的耐蚀性优于后者。

关键词: TiO_2 薄膜,Ni-P 化学镀,电化学辅助沉积,耐蚀性

中图分类号:TG178 文献标识码:A 文章编号:1002-6495(2007)05-0323-03

ELECTROCHEMICALLY AIDED DEPOSITION OF TiO_2 FILMS ON Ni-P PRE-PLATED A3 CARBON STEEL

LIU Yi-ru, GAO Zhi-ming, ZHANG Zheng, SHI Da-fei

School of Materials Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072

Abstract: On Ni-P pre-plated A3 carbon steel sample TiO_2 films were fabricated in laboratory with TiPO_4 solutions by electrochemically aided deposition. The surface appearance of TiO_2 films was observed by SEM, and surface elements was analyzed by EDS. The electrochemical corrosion of the Ni-P/ TiO_2 composite films and Ni-P coating were investigated respectively by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and polarization curves in 3.5% NaCl solution. The result indicated that there was obvious difference between them in electrochemical corrosion behavior, and the corrosion resistance of the former was higher than that of the latter.

Keywords: TiO_2 film, Ni-P chemical plating, electrochemically aided deposition, corrosion resistance

目前国内外对溶胶—凝胶法制备 TiO_2 薄膜研究较多^[1~6],但与此相比电化学辅助沉积法所需成本更低,更适合生产不同形状工件,在一定的沉积时间和电压范围内可控制膜的厚度与表面形貌,是具有工业化前途的成膜方法。

由于碳钢表面的成分和相组织很不均匀, TiO_2 薄膜和碳钢表面的结合力极差,故直接在 A3 钢表面上很难沉积形成完整的 TiO_2 薄膜。本文借鉴了宋来洲等^[3]采用化学镀/溶胶—凝胶复合法在 A3 钢表面制备 TiO_2 修饰膜的经验,先在 A3 钢表面制备 Ni-P 镀层,再用电化学辅助沉积法在该镀层表面制得 TiO_2 薄膜,并研究此复合膜的耐蚀性。

1 实验方法

1.1 A3 钢基体 Ni-P 镀层表面 TiO_2 薄膜的制备

表面预处理。基体选用 A3 钢片($20 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$),用水砂纸打磨至 1200#,除油、水洗并干燥。

收稿日期:2006-07-30 初稿;2006-10-20 修改稿

作者简介:刘奕茹(1980-),女,硕士研究生,研究方向为材料的腐蚀与防护

* Tel:022-27407179 E-mail:gaozhiming@tju.edu.cn

化学镀 Ni-P 镀液主要成分为 $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, $\text{NaH}_2\text{PO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{COOH}$, CH_3COONa ,均为分析纯,按一定步骤配制,并通过滴加氨水调节溶液 pH 值至 4.4~4.8。将经过表面预处理的 A3 钢片用稀盐酸活化后,置于温度在 85°C~91°C 之间的镀液中反应 30 min。

TiO_2 薄膜的制备。采用电化学辅助沉积法制备 TiO_2 薄膜。工作电极为表面覆盖 Ni-P 镀层的 A3 钢片,辅助电极为 Ti 片($20 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$),参比电极为饱和甘汞电极(SCE),工作电极与辅助电极之间距离约为 3.5 cm。将自制的 TiPO_4 溶液用碳酸钾调节 pH 值至 2,即为制备 TiO_2 薄膜的电解液。用 ZF-3 恒电位仪控制电位,在开路电位的基础上加 100 mV 直流电压,在室温下反应 10 min。

1.2 显微形貌与成分分析

采用 PHILIPS 公司 XL30 型环境扫描电子显微镜(SEM),分别观察了 Ni-P 镀层和 TiO_2 薄膜的表观形貌,并用 ISIS300 型射线能谱仪(EDS)分析了 TiO_2 薄膜的成分。

1.3 在 3.5%NaCl 溶液中耐蚀性的测试

电化学阻抗谱测试。电化学阻抗谱测试体系采用三电极体系,参比电极为饱和甘汞电极,辅助电极为 Pt 电极。工作

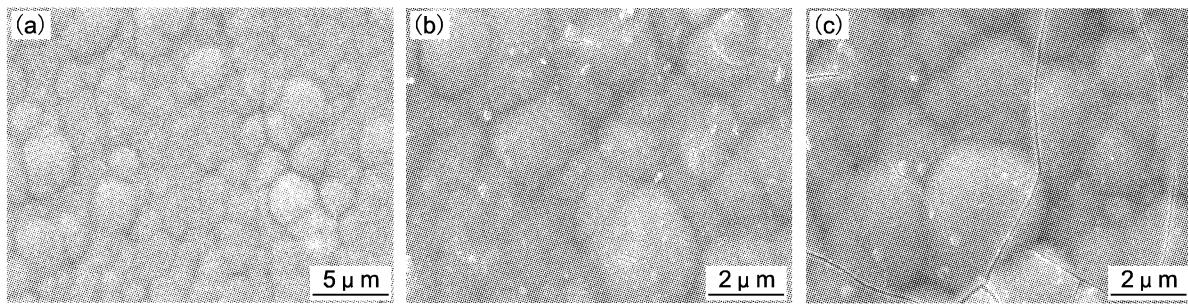


Fig. 1 SEM image of (a) Ni-P sample with poorly controlled techniques, (b) Ni-P/TiO₂ Sample and (c) Ni-P/TiO₂ Sample with poorly controlled techniques

电极分别为A3钢片、表面覆盖Ni-P镀层的A3钢片(Ni-P试样)及在Ni-P镀层上电化学辅助沉积TiO₂薄膜的A3钢片(Ni-P/TiO₂试样),均用石蜡封样,留出的工作表面为10 mm×10 mm。实验在室温进行下,腐蚀介质为3.5% NaCl溶液,工作电极和辅助电极相距约4 cm。选用Princeton公司生产的PARSTAT 2273及相应的软件完成各试样的阻抗谱测试。施加的正弦波电位幅值为10 mV,频率扫描范围100 kHz~10 mHz。对数扫频,每倍频程8步。

极化曲线测试。测试体系及仪器同上,用动电位扫描法测出试样Ni-P和Ni-P/TiO₂的极化曲线,扫描速度1 mV/s。

2 结果与讨论

2.1 TiO₂薄膜表面形貌与成分

图1为环境扫描电镜观察的沉积膜表面形貌。图1c是电化学辅助沉积TiO₂的工艺没有控制好的试样。通过比较可发现3个试样的表观形貌比较接近,表面都分布着粒径约为1 μm~3 μm的球状颗粒,初步推断是因为TiO₂薄膜太薄导致有此共性;图1c显示的试样表面有微裂纹,说明在Ni-P镀层上的确存在一层薄膜;图1b和图1c中的小白点有可能是TiO₂分布不均匀,形成的团簇。

由图2Ni-P/TiO₂试样表面能谱图可知,Ni-P/TiO₂试样表面中含Ti元素,由于表面覆盖Ni-P镀层的A3钢片在含有Ti³⁺的电解液中进行的电化学反应中做阳极,故推测薄膜中一定存在TiO₂。然而Ti的谱峰较弱,Ti原子的百分含量只有0.74%,Ni和P的谱峰较强,二者的原子百分含量分别为55.41%和16.26%,还是可能因为TiO₂薄膜太薄,导致电子束可穿透Ni-P/TiO₂复合膜到达基体,这与TiO₂薄膜的SEM照片的分析结果一致。

2.2 Ni-P/TiO₂复合膜在3.5%NaCl溶液中的耐蚀性能

2.2.1 电化学阻抗谱特征 A3钢、Ni-P和Ni-P/TiO₂试样分别在3.5% NaCl溶液中的阻抗谱及拟合曲线如图3所示。由

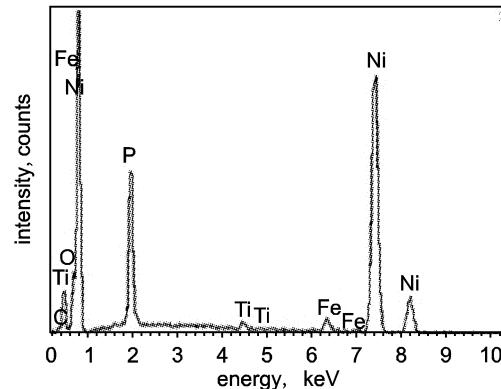


Fig. 2 EDS spectrum of TiO₂ film

Bode图可见,Ni-P/TiO₂试样在整个频率范围内阻抗模值|Z|明显高于A3钢和Ni-P试样的总阻抗模值,A3钢试样的最小,说明Ni-P/TiO₂复合膜阻挡Cl⁻腐蚀的能力最强,其次是Ni-P镀层,A3钢样最差;此外,从相频特征曲线还可看出Ni-P试样在中频范围内相角保持在80°左右,与涂层的特征相似,Ni-P/TiO₂试样则出现了两个时间常数的双容抗弧特征,说明Ni-P/TiO₂复合膜具有微孔结构。这些阻抗谱特征说明A3钢试样在化学镀Ni-P进而电化学辅助沉积TiO₂薄膜前后,在3.5% NaCl溶液中的腐蚀机理发生了改变。

A3钢、Ni-P试样的EIS可用图4所示的等效电路模型拟合。 R_s 为溶液电阻; R_{ct} 为基体与溶液两相界面的电荷转移电阻,反映基体金属腐蚀速度;CPE为常相位角元件。

拟合Ni-P/TiO₂试样EIS等效电路如图5所示。 R_s 为溶液电阻; R_p 为电解质渗入膜层引起的微孔电阻,反映膜中离子在电场中迁移时受到阻力大小; R_{ct} 为基体与溶液两相界面的电荷转移电阻,反映基体金属腐蚀速度;CPE₁反映Ni-P/TiO₂复合膜性质;CPE₂为基体与溶液两相界面的双电层。

比较表1和表2可知,Ni-P/TiO₂复合膜的 R_{ct} 高于Ni-P镀层的 R_{ct} ;对于Ni-P/TiO₂复合膜,CPE₁的n值比较接近于1,CPE₁-Yo、CPE₂-Yo较小, R_p 、 R_{ct} 较大,这些参数说明TiO₂薄膜表面粗糙度较低,结构比较致密,从而增大了膜中Cl⁻在电场中迁移时的阻力,减缓了Cl⁻的侵蚀作用。所以在腐蚀介质为3.5% NaCl溶液中,相对于只有Ni-P镀层的A3钢片,表面覆盖Ni-P/TiO₂复合膜的A3钢片耐蚀性更优越。

2.2.2 极化行为 由图6可见,试样Ni-P和Ni-P/TiO₂在

Table 1 Circuit components parameters in equivalent circuits of EIS for sample A3 and sample Ni-P

item	$R_s, \Omega \cdot \text{cm}^2$	CPE-Yo, $\Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-n}$	CPE-n	$R_{ct}, \Omega \cdot \text{cm}^2$
A3	10.53	0.0007867	0.8163	1690
Ni-P	20.39	6.138E-6	0.9759	1.909E5

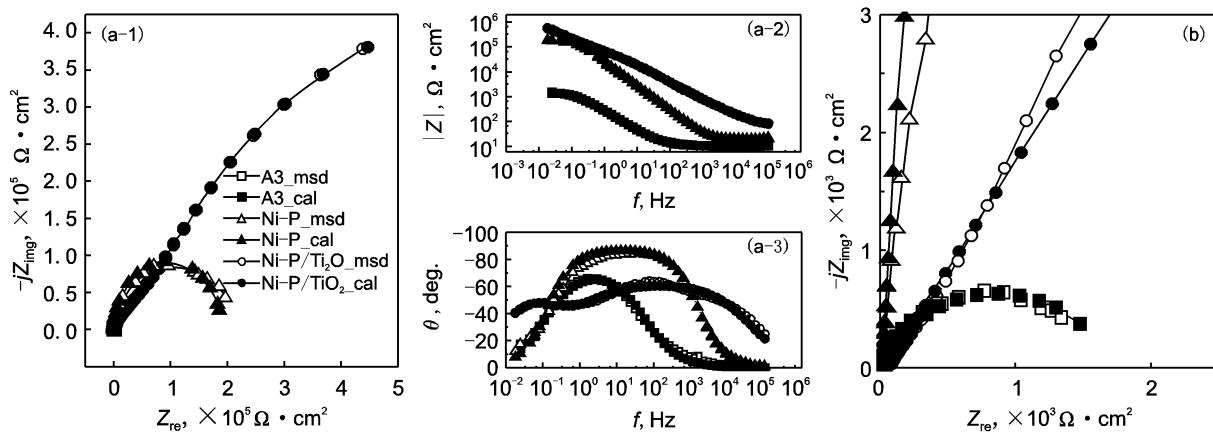


Fig.3 (a) EIS(msd) and fitting curves(cal) of sample A3,Ni-P and Ni-P/TiO₂, (b) Selective enlargement of Nyquist plots

Table 2 Parameters of circuit components in equivalent circuits of EIS for Sample Ni-P/TiO₂

item	$R_s, \Omega \cdot \text{cm}^2$	CPE1-Yo $, \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-n}$	CPE ₁ -n	$R_p, \Omega \cdot \text{cm}^2$	CPE ₂ -Yo $, \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-n}$	CPE ₂ -n	$R_{ct}, \Omega \cdot \text{cm}^2$
Ni-P/TiO ₂	18.82	9.089E-6	0.6935	5.218E4	1.38E-5	0.7654	3.842E5

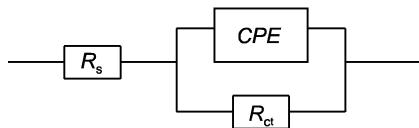


Fig.4 Equivalent circuits of EIS for sample A3 and sample Ni-P

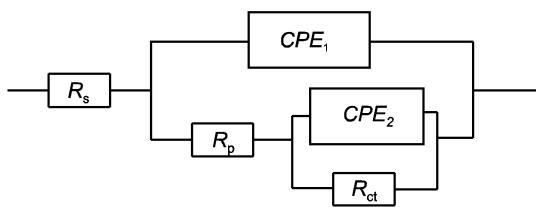


Fig.5 Equivalent circuits of EIS for Sample Ni-P/TiO₂

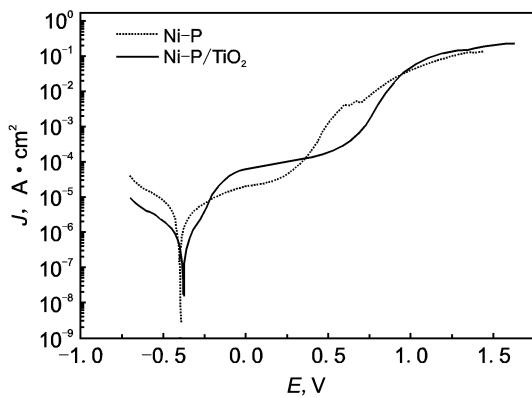


Fig.6 Polarization curves of sample Ni-P and sample Ni-P/TiO₂ in 3.5% NaCl solution

3.5% NaCl 溶液中阳极极化行为不同, 导致前者的工作表面变黑并伴有部分蚀坑, 而后者则只出现均匀分布的蚀坑。Ni-

P/TiO₂ 复合膜相对 Ni-P 镀层击穿电位(电流密度为 150 $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ 时)正移 238 mV, 前者的自腐蚀电位比后者略有提高。再次证明 Ni-P/TiO₂ 复合膜在该介质中耐蚀性优于 Ni-P 镀层。

3 结论

1. 化学镀 Ni-P 的 A3 钢片, 在自制的 Ti-PO₄ 电解液中通过电化学辅助沉积可在其表面生成致密、表面粗糙度较低的 TiO₂ 薄膜, 形成 Ni-P/TiO₂ 复合膜。
2. 常温下在腐蚀介质为 3.5% NaCl 溶液中, Ni-P/TiO₂ 复合膜与 Ni-P 镀层的腐蚀机理不相同, 前者的耐蚀性优于后者。
3. 电化学辅助沉积法制备 TiO₂ 薄膜成本低廉, 工艺简单, 可在不同的基体上采用此法制备 TiO₂ 薄膜。

参考文献:

- [1] Djaoued Y, Brüning R, Bersanic D. Sol-gel nanocrystalline brookite-rich titania films [J]. Materials Letters, 2004, 58: 2618.
- [2] Sonawane R S, Hegde S G. Preparation of titanium (IV) oxide thin film photocatalyst by sol-gel dip coating [J]. Materials Chemistry and Physics, 2002, 77: 744.
- [3] 宋来洲, 高志明, 宋诗哲. 人工神经网络优化碳钢表面 TiO₂ 修饰膜制备工艺[J]. 中国腐蚀与防护学报, 2001, 21: 101.
- [4] 胡娟, 邓建刚, 何水样. 纳米级二氧化钛制备方法的比较研究[J]. 材料科学与工程, 2001, 19: 71.
- [5] 崔晓莉, 江志裕. 纳米 TiO₂ 薄膜的制备方法[J]. 化学进展, 2002, 14: 325.
- [6] 银董红, 邓菁英, 陈恩伟. 溶胶-凝胶法制备二氧化钛薄膜的研究进展[J]. 工业催化, 2004, 12: 1.